



NEWS ANNOUNCEMENT

FOR IMMEDIATE RELEASE

※本リリースは 2020 年 3 月 23 日に発表されたリリースを翻訳したものです

タワーセミコンダクター、パワーマネジメント IC の消費電力とダイサイズを劇的に低減する

新しいテクノロジー向けデザインキットのリリースを発表

これまでになく $6m\Omega mm^2$ の低オン抵抗と 24V の動作電圧で 35% 以上の効率改善を実現し、

コンシューマー用、産業用、車載用、コンピューティング用市場に対応

イスラエル、ミグダール ハエメク、2020 年 3 月 23 日- 先進のアナログ半導体ファンドリソリューションのリーダーである **タワーセミコンダクター**(NASDAQ/TASE:TSEM)は、本日、IC チップの価格競争力を高める 35%以上の電力効率改善、それに相当するチップ面積縮小が可能で、新しい **0.18um 高性能パワーマネジメント技術** のデザインキットのリリースを発表しました。この新しい技術を用いることで、最大 24V までのスケーラブルな IC 動作が実現可能であり、世界的に成長しているコンシューマー用、産業用、車載用、コンピューティング用の市場にとって理想的な技術です。今回発表の新ラインナップが、当社既存の低電圧 65nm パワーBCD プロセス、ならびに高耐圧 140V リザーブ・オン・バルクおよび 200V SOI 技術に追加されることにより、一貫したデザインツールとデザイン実績を持つ一つのファンドリ(当社)が 1.2V~200V の全動作範囲にわたって最高クラスの性能をお客様に提供できることとなります。この技術は、かねてより高い評価をいただいている高性能 0.18um パワーマネジメントプラットフォームシリーズの第 6 世代と位置付けられます。技術の多くは、前世代と互換性があり、既存の設計資産をより効率的に新しいプロセスに組み込むことができます。

タワーセミコンダクター パワーマネジメント事業部担当副社長の Shimon Greenberg は次のように述べています。「お客様に当社以外にはない画期的なパフォーマンスを提供する新技術のデザインキットリリースを発表

できることを非常に嬉しく思います。私たちは、お客様が高度な製品を市場に投入し、半導体市場において成長著しいパワー分野でシェアを獲得することができるよう、最先端パワーマネジメント技術の開発と提供を継続していきます。」

具体的には、このプロセスは、24V 駆動時に $6\text{m}\Omega\text{mm}^2$ という圧倒的に低いオン抵抗のパワートランジスタを小面積、スケラブルなレイアウト設計、および少ないマスク数で実現することによって、お客様の製品の性能向上とコスト競争力強化を両立させるものです。あらゆる動作条件において高耐圧を確保するロバストな設計は、IC の信頼性を高め、DC/DC コンバータ、ロードスイッチ、ラップトッププロセッサやファンに使用される PMIC とモータドライバ、コンシューマー、コンピューティング、車載、産業市場で 사용되는ドローンおよびロボットモータドライバなどの用途における、ハイパワーモノリシック IC にとって理想的なプロセスです。

タワーセミコンダクターのテクノロジーについて詳細は、[こちら](#) をご覧ください。

タワーセミコンダクターについて

タワーセミコンダクター株式会社 (NASDAQ: TSEM, TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドリリーダーで、コンシューマー、産業機械、車載用、モバイル、インフラ、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で集積回路(IC)の技術・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先端の革新的なアナログテクノロジーの提供を通じて、意義あるサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-image sensor、パワーマネジメント(BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントを提供し、IDM やファブレス企業向けには Transfer Optimization and development Process Services(TOPS:プロセス移管サービス)を提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワーセミコンダクターはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)、TPSCo が保有する日本の 3 か所(200mm と 300mm)に生産拠点が 있습니다。詳細は www.towersemi.com をご覧ください。

###

Tower Semiconductor Company Contact: Orit Shahar | +972-74-7377440 | oritsha@towersemi.com

Tower Semiconductor Investor Relations Contact: Noit Levy | +972-4-604-7066 | noitle@towersemi.com